

Title (en)
Relay.

Title (de)
Relais.

Title (fr)
Relais.

Publication
EP 0574058 A2 19931215 (DE)

Application
EP 93201385 A 19930514

Priority
CH 185192 A 19920611

Abstract (en)
In order to increase the dielectric strength of an encapsulated, gas-filled relay with respect to that which can be achieved using a relay having the same dimensions and whose interior is filled with dry air or an inert gas, the relay interior is filled with a filling gas at normal pressure, which filling gas contains at least one electrically negative gas. The housing consists of plastic. The plastic encapsulation is of sealed design and is matched to the filling gas such that the electrically negative gas is prevented sufficiently well from diffusing away. In consequence, the required dielectric strength does not fall below a specified value during the life of the relay.

Abstract (de)
Zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit eines gekapselten, gasgefüllten Relais gegenüber jener, die mit einem Relais gleicher Abmessungen erreichbar ist, dessen Innenraum mit trockener Luft oder einem inerten Gas gefüllt ist, wird der Relaisinnenraum mit einem Füllgas, das mindestens ein elektronegatives Gas enthält, unter Normaldruck gefüllt. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Die Kunststoffkapselung wird dicht ausgeführt und ist mit dem Füllgas so abgestimmt, dass ein Wegdiffundieren des elektronegativen Gases genügend stark behindert wird. Damit sinkt die geforderte Spannungsfestigkeit während der Lebensdauer des Relais nicht unter einen spezifizierten Wert.

IPC 1-7
H01H 50/02; **H01H 9/34**

IPC 8 full level
H01H 49/00 (2006.01); **H01H 50/02** (2006.01); **H01H 51/29** (2006.01); **H01H 33/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01H 51/29 (2013.01 - EP US); **H01H 33/22** (2013.01 - EP US); **H01H 50/023** (2013.01 - EP US); **H01H 50/026** (2013.01 - EP US);
H01H 2050/025 (2013.01 - EP US)

Cited by
US5532750A

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0574058 A2 19931215; **EP 0574058 A3 19940105**; **EP 0574058 B1 19960612**; AT E139367 T1 19960615; CA 2098145 A1 19931212;
CH 683727 A5 19940429; DE 59302884 D1 19960718; ES 2090845 T3 19961016; JP H0652769 A 19940225; US 5554963 A 19960910

DOCDB simple family (application)
EP 93201385 A 19930514; AT 93201385 T 19930514; CA 2098145 A 19930610; CH 185192 A 19920611; DE 59302884 T 19930514;
ES 93201385 T 19930514; JP 13875393 A 19930610; US 38469295 A 19950206